

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.10B**條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命

Nexchip Semiconductor Corporation

合肥晶合集成電路股份有限公司

執行董事兼董事長

蔡國智先生

香港，2026年7月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

合肥晶合集成电路股份有限公司
关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易
暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 216,167,000 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 21,616,700 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 194,550,300 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价 32.30 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 67.79 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 216,167,000 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 7 月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“晶合集成”，英文简称为“NEXCHIP”，股份代号为“2249”。

本次发行上市前（截至 2026 年 7 月 9 日），公司的总股本为 2,007,591,697 股（含回购专用证券账户股份数 62,088,500 股）。本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
A 股股东	2,007,591,697	100.00%	2,007,591,697	90.28%	2,007,591,697	88.98%
H 股股东	-	-	216,167,000	9.72%	248,592,000	11.02%
股份总数	2,007,591,697	100.00%	2,223,758,697	100.00%	2,256,183,697	100.00%

本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

序号	股东名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
				假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
		持股数量 (股)	比例 (%)	持股数量 (股)	比例 (%)	持股数量 (股)	比例 (%)
1	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	468,474,592	23.34	468,474,592	21.07	468,474,592	20.76
	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	328,736,799	16.37	328,736,799	14.78	328,736,799	14.57
	小计	797,211,391	39.71	797,211,391	35.85	797,211,391	35.33
2	华勤技术股份有限公司	120,368,109	6.00	120,368,109	5.41	120,368,109	5.34
	合肥勤合电子科技有限公司	100,379,585	5.00	100,379,585	4.51	100,379,585	4.45
	小计	220,747,694	11.00	220,747,694	9.93	220,747,694	9.78
3	力晶创新投资控股股份有限公司	161,984,487	8.07	161,984,487	7.28	161,984,487	7.18
股份总数		1,179,943,572	58.77	1,179,943,572	53.06	1,179,943,572	52.30

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日